

高导热系数灌封胶 87-3WA/5010B

一、简介:

室温硬化型高导热灌封胶是一种双组份硬化型灌封材料,它在固化后成为致密性固体结构,具有良好的韧性(耐高低温冲击),高导热性,可起到保护、防水、保密的作用。

二、常规性能:

测试项目	测试方法或条件	87-3WA	5010B
外观	目测	白色粘稠液体	无色透明液体
密度	25°C g/cm ³	1.5-1.6	1.00-1.10
粘度	25°C mpa·s	3000-5000	20-30
保存期限	室温通风	半年	半年

三、使用工艺:

项目	单位或条件	87-3WA/5010B
混合比例	重量比	100:15
可使用时间	25°C, 35g, hrs	0.5
固化条件	°C/hrs	25/24 或 60/3-4

四、用途: 适用于太阳能转换器,传感器,混合模块电路,小型电子元件等灌封。

五、固化后特性:

项目	单位或条件	87-3WA/5010B
硬度	Shore-D	70
导热系数	W / M°C	0.85
体积电阻率	25°C, Ω·cm	1.0×10 ¹³
绝缘强度	25°C, kV/mm	15
冲击强度	Kg/cm ²	7
介电常数	25°C, 1MHZ	4.0±0.05
介质损耗角正切	25°C, 1MHZ	0.02

六、贮存、运输及注意事项:

1. 此类产品非危险品,按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶。
2. 请看准所使用产品型号,然后对号入座;准确称量后,请充分搅拌均匀。
3. 被灌封器件经 100°C/1~1.5hrs 干燥,去除水份,冷却至 30~40°C。
4. 包封时注意浸渍速度不宜过快,以确保浸渍均匀。

七、包装规格: 包装为 A: 25KG 或 B: 5KG。

备注：以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。